

【公報種別】特許法第 17 条の 2 の規定による補正の掲載

【部門区分】第 7 部門第 2 区分

【発行日】令和 1 年 5 月 9 日 (2019.5.9)

【公開番号】特開 2017-188528 (P2017-188528A)

【公開日】平成 29 年 10 月 12 日 (2017.10.12)

【年通号数】公開・登録公報 2017-039

【出願番号】特願 2016-75046 (P2016-75046)

【国際特許分類】

H 0 1 L 23/12 (2006.01)

【F I】

H 0 1 L 23/12 K

【手続補正書】

【提出日】平成 31 年 3 月 26 日 (2019.3.26)

【手続補正 1】

【補正対象書類名】特許請求の範囲

【補正対象項目名】全文

【補正方法】変更

【補正の内容】

【特許請求の範囲】

【請求項 1】

半導体素子実装用の基板であって、対向する第 1 主面と第 2 主面とにそれぞれ導体パターンを有する基板と、

対向する第 1 面及び第 2 面を有し、上記第 1 主面における導体パターンに上記第 2 面を接合した接合領域を有する板状電極部材と、を備え、

上記板状電極部材は、上記第 1 面に凹部を上記第 2 面に凸部をそれぞれ有し、この凹部及び凸部は、当該板状電極部材の厚み方向において上記接合領域を上記第 1 面及び上記第 2 面に投影した投影領域に位置し、

上記凸部は、半円球状又は角柱形状である、

ことを特徴とする半導体装置。

【請求項 2】

半導体素子実装用の基板であって、対向する第 1 主面と第 2 主面とにそれぞれ導体パターンを有する基板と、

対向する第 1 面及び第 2 面を有し、上記第 1 主面における導体パターンに上記第 2 面を接合した接合領域を有する板状電極部材と、を備え、

上記板状電極部材は、上記第 1 面に凹部を上記第 2 面に凸部をそれぞれ有し、この凹部及び凸部は、当該板状電極部材の厚み方向において上記接合領域を上記第 1 面及び上記第 2 面に投影した投影領域に位置し、

上記板状電極部材は、当該板状電極部材の厚み方向において上記凹部と上記凸部とを貫通する穴を有する、

ことを特徴とする半導体装置。

【請求項 3】

半導体素子実装用の基板であって、対向する第 1 主面と第 2 主面とにそれぞれ導体パターンを有する基板と、

対向する第 1 面及び第 2 面を有し、上記第 1 主面における導体パターンに上記第 2 面を接合した接合領域を有する板状電極部材と、を備え、

上記板状電極部材は、当該板状電極部材の端部に設けた複数の切り込み間に位置する切欠き片を折り曲げた状態の舌片を上記接合領域に有する、

ことを特徴とする半導体装置。

【請求項 4】

半導体素子実装用の基板であって、対向する第 1 主面と第 2 主面とにそれぞれ導体パターンを有する基板と、

対向する第 1 面及び第 2 面を有し、上記第 1 主面における導体パターンに上記第 2 面を接合した接合領域を有する板状電極部材と、を備え、

上記板状電極部材は、上記接合領域に切欠き部を有し、かつ、上記接合領域における当該板状電極部材の断面積が接合領域外における当該板状電極部材の断面積に比して同じあるいは小さい、

ことを特徴とする半導体装置。

【請求項 5】

上記基板の第 1 主面、上記接合領域、及び上記板状電極部材を封止する封止材をさらに備える、請求項 1 から 4 のいずれか 1 項に記載の半導体装置。